

2025年3月期 第1四半期 決算説明資料

マクニカホールディングス株式会社

2024年7月29日

2024年度 第1四半期 業績ハイライト

単位：億円	第1四半期				通期	
	実績	前年同期比	前四半期比	計画	進捗率	
売上高	2,563	▲222 ▲8%	+279 +12%	11,000	23%	
半導体事業	2,187	▲314 ▲13%	+245 +13%	9,600	23%	
ネットワーク事業	376	+92 +32%	+34 +10%	1,400	27%	
営業利益	120	▲86 ▲42%	▲4 ▲3%	640	19%	
半導体事業	87	▲96 ▲53%	▲18 ▲18%	510	17%	
ネットワーク事業	34	+10 +44%	+15 +78%	130	26%	
親会社株主に帰属する純利益	80	▲56 ▲41%	▲49 ▲38%	420	19%	
営業キャッシュフロー	90					
平均為替レート（¥/USD）	153.14円			145円（FY24計画）		

● 第1四半期は、半導体事業は調整局面が続き、ネットワーク事業は国内・海外ともに好調を維持

半導体事業は、グローセルの連結を開始したが、産業機器向けビジネスの減少もあり、前年同期比▲314億/▲13%
ネットワーク事業は、エンドポイントセキュリティ関連商品が好調に推移し、前年同期比+92億/+32%と大幅増

● 第2四半期以降は、半導体事業は産業機器市場は年度後半からの回復を予想

ネットワーク事業は引続きセキュリティ関連商品を中心に国内・海外共に高い成長を維持する予想

● 2024年度通期見通し

上記の状況から、2024年5月7日公表の予想値を据え置き

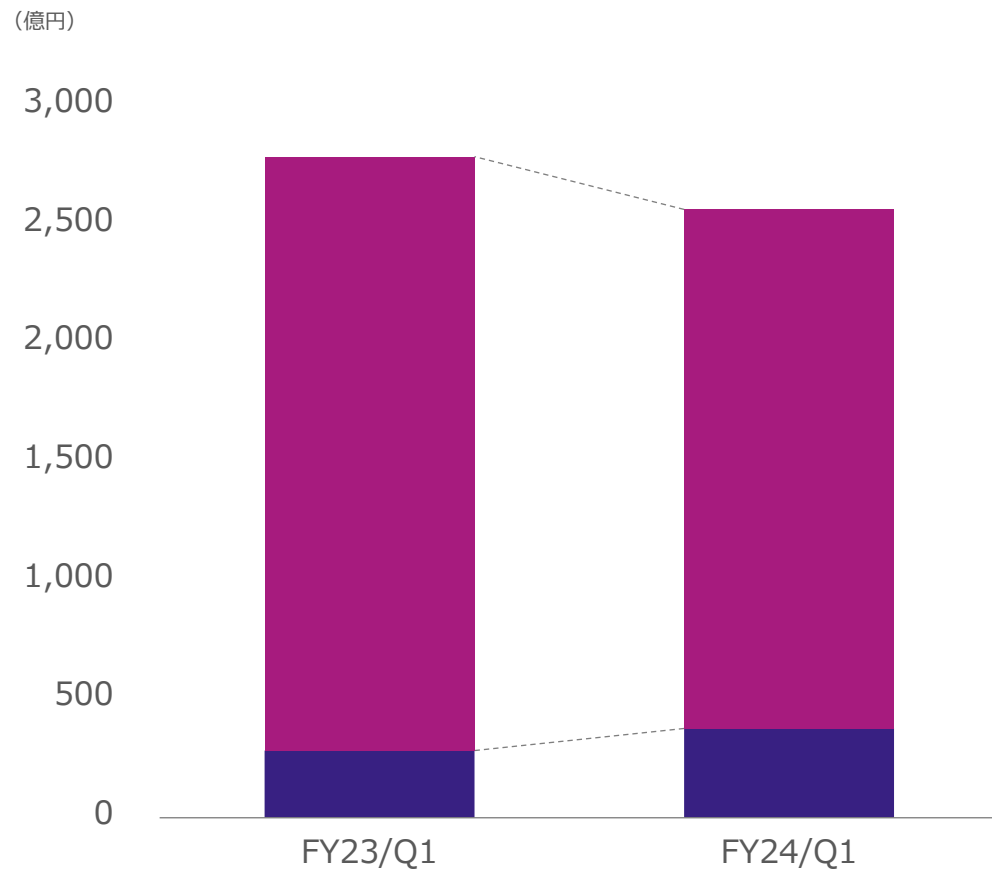
配当の状況（1株当たり・分割前）

	中間	期末	年間	配当性向
2023年度	80円	120円	200円	25%
2024年度	105円※1	105円※2	210円※2	30%※3

※1 予想 ※2 予想、株式分割前、※3 予想

セグメント別：売上高

2,563億円 前年同期比▲8.0%

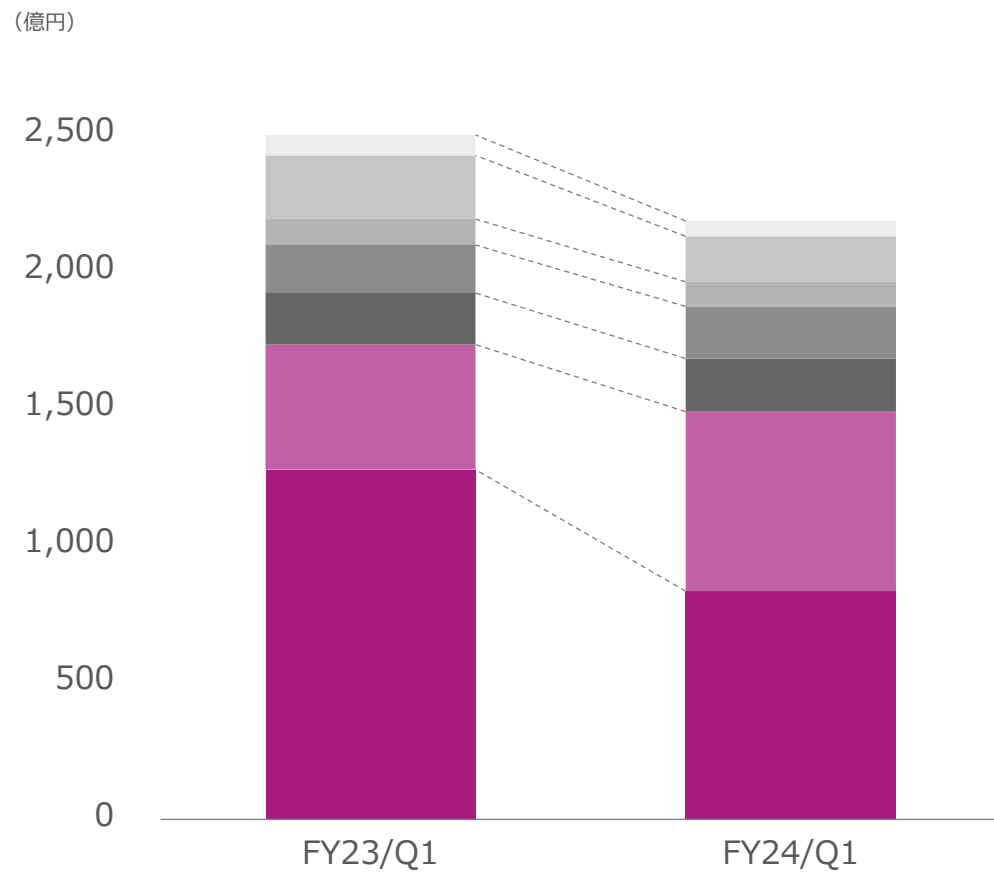


前年同期比▲8.0%

	FY23/Q1		FY24/Q1		前年同期比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
(単位：億円)						
半導体	2,501	90%	2,187	85%	▲314	▲13%
ネットワーク	284	10%	376	15%	+92	+32%
合計	2,786	100%	2,563	100%	▲222	▲8.1%

半導体事業（用途別）：売上高

2,187億円 前年同期比▲12.6%

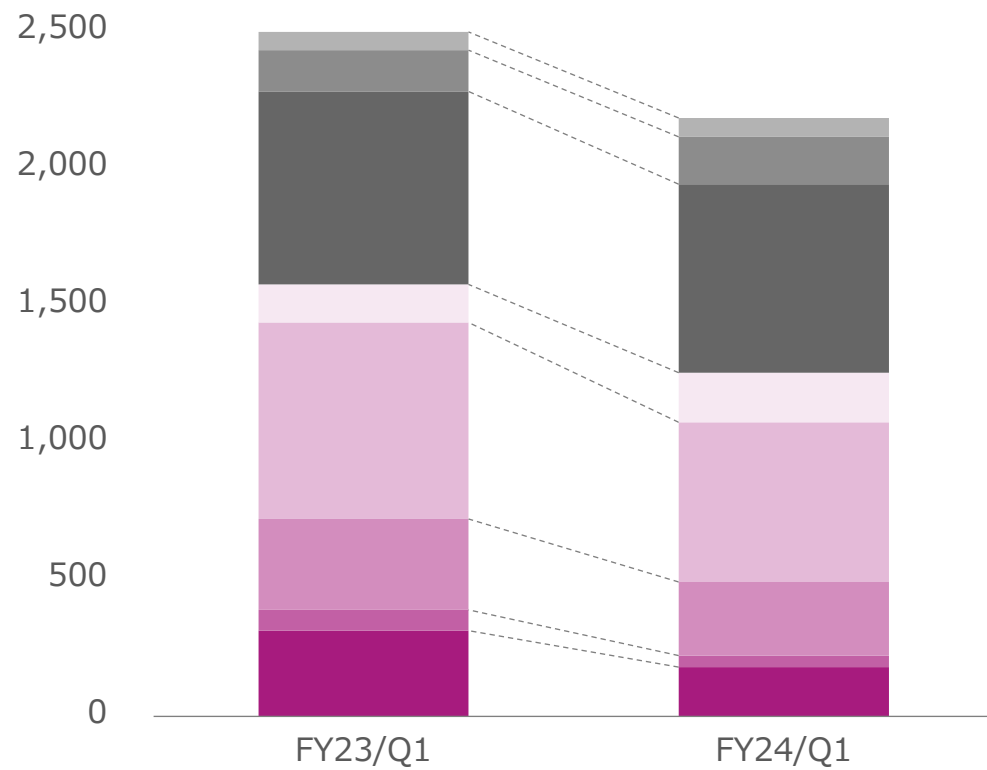


(単位：億円)	FY23/Q1		FY24/Q1		前年同期比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
通信端末	75	3%	56	3%	▲19	▲25%
通信インフラ	232	9%	167	8%	▲65	▲28%
OA・周辺機器	95	4%	89	4%	▲6	▲6%
コンピュータ	175	7%	191	9%	+16	+9%
民生機器	189	8%	195	9%	+6	+3%
車載	457	18%	656	30%	+199	+43%
産業機器	1,278	51%	834	38%	▲445	▲35%
合計	2,501	100%	2,187	100%	▲314	▲12.6%

半導体事業（品目別）：売上高

2,187億円 前年同期比▲12.6%

(億円)

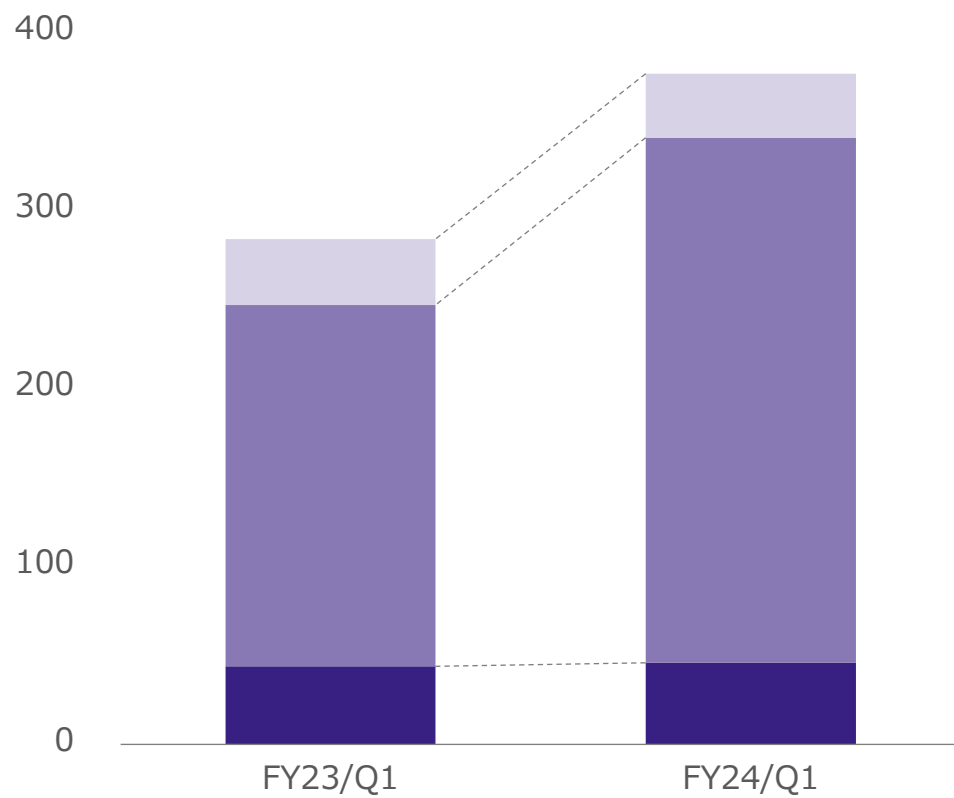


(単位：億円)	FY23/Q1		FY24/Q1		前年同期比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
その他	67	3%	69	3%	+2	+3%
電子デバイス	151	6%	173	8%	+22	+14%
その他標準IC	704	28%	689	32%	▲15	▲2%
メモリー	139	6%	181	8%	+42	+30%
アナログ	718	29%	583	27%	▲135	▲19%
ASSP	332	13%	269	12%	▲63	▲19%
ASIC	76	3%	41	2%	▲35	▲46%
PLD	313	13%	181	8%	▲132	▲42%
合計	2,501	100%	2,187	100%	▲314	▲12.6%

ネットワーク事業（品目別）：売上高

376億円 前年同期比+32.3%

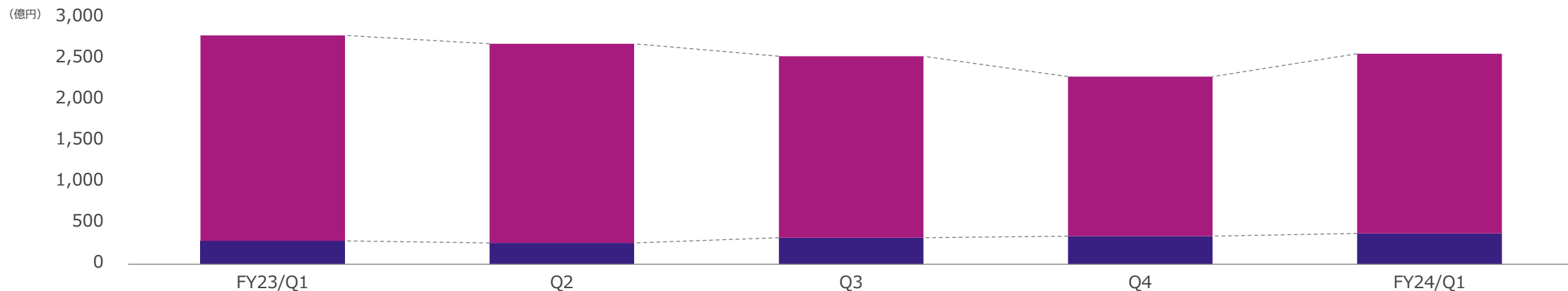
(億円)



(単位：億円)	FY23/Q1		FY24/Q1		前年同期比	
	実績	構成比	実績	構成比	増減額	増減率
ハードウェア	37	13%	36	10%	▲2	▲5%
ソフトウェア	203	72%	295	78%	+91	+45%
サービス	44	15%	46	12%	+2	+5%
合計	284	100%	376	100%	+92	+32.3%

Appendix

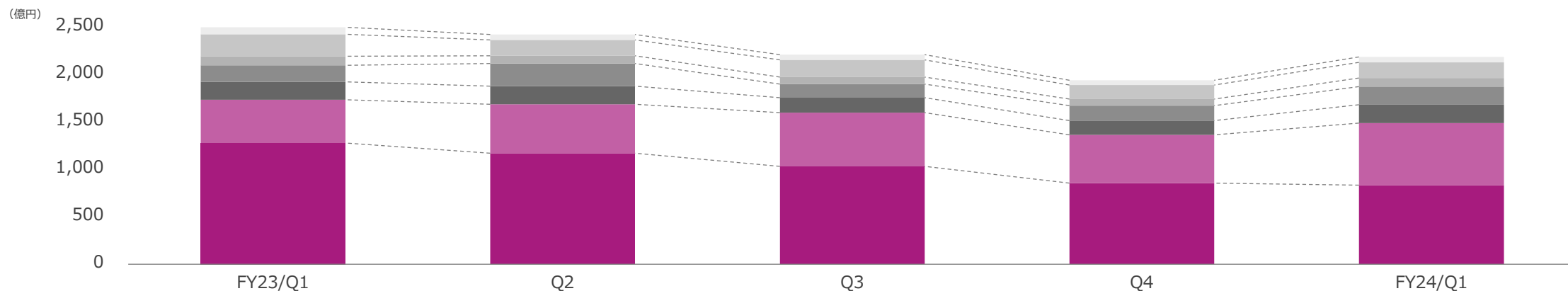
四半期推移 セグメント別：売上高



実績 構成比 (億円 %)	セグメント	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1	
		売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比	売上高	構成比
実績 構成比 (億円 %)	半導体	2,501	90%	2,424	90%	2,210	87%	1,942	85%	2,187	85%
	ネットワーク	284	10%	260	10%	323	13%	342	15%	376	15%

YoY QoQ	セグメント	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1	
		YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ
YoY QoQ	半導体	+14%	+8%	+7%	▲3%	▲12%	▲9%	▲16%	▲12%	▲13%	+13%
	ネットワーク	+29%	▲4%	+7%	▲9%	+32%	+24%	+16%	+6%	+32%	+10%

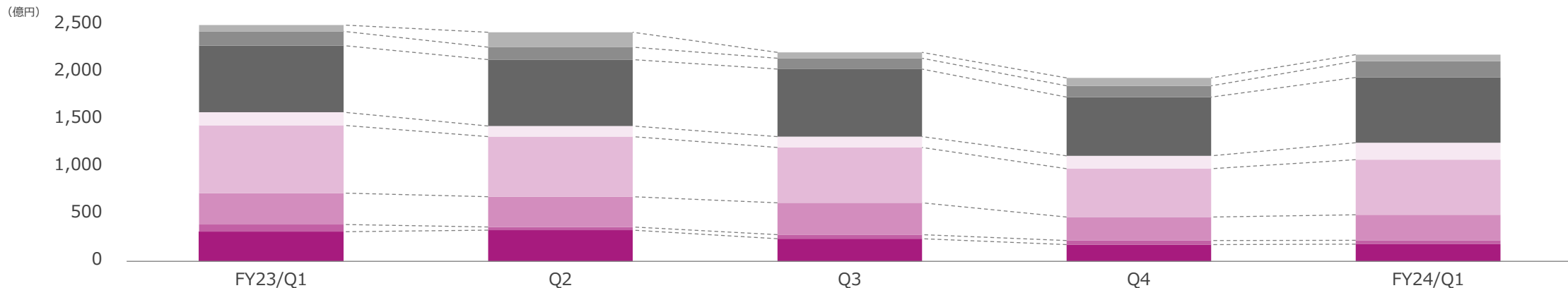
四半期推移 半導体事業（用途別）：売上高



		FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1	
実績 構成比 (億円 %)	通信端末	75	3%	59	2%	55	2%	51	2%	56	3%
	通信インフラ	232	9%	166	7%	182	8%	147	8%	167	8%
	OA・周辺機器	95	4%	81	3%	74	3%	71	4%	89	4%
	コンピュータ	175	7%	241	10%	143	6%	156	8%	191	9%
	民生機器	189	8%	191	8%	159	7%	152	8%	195	9%
	車載	457	18%	516	21%	566	26%	508	26%	656	30%
	産業機器	1,278	51%	1,171	48%	1,033	47%	857	44%	834	38%
YoY QoQ	通信端末	+12%	+16%	▲14%	▲22%	▲22%	▲7%	▲21%	▲6%	▲25%	+9%
	通信インフラ	▲41%	+4%	▲34%	▲29%	▲44%	+10%	▲34%	▲20%	▲28%	+14%
	OA・周辺機器	+1%	▲1%	▲19%	▲15%	▲32%	▲9%	▲26%	▲4%	▲6%	+26%
	コンピュータ	▲12%	+15%	+7%	+38%	▲29%	▲41%	+3%	+9%	+9%	+22%
	民生機器	+19%	+7%	+2%	+2%	▲16%	▲17%	▲13%	▲4%	+3%	+28%
	車載	+31%	+7%	+24%	+13%	+19%	+10%	+19%	▲10%	+43%	+29%
	産業機器	+37%	+9%	+15%	▲8%	▲9%	▲12%	▲27%	▲17%	▲35%	▲3%

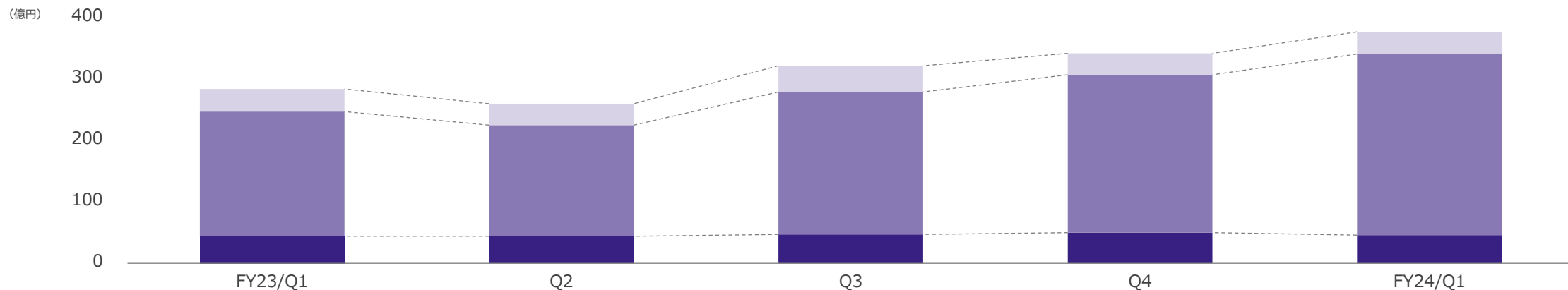
(株)グローセルは2024年3月末B/S連結、2024年4月よりP/L連結（半導体事業）

四半期推移 半導体事業（品目別）：売上高



		FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1	
実績 構成比 (億円 %)	その他	67	3%	157	6%	62	3%	85	4%	69	3%
	電子デバイス	151	6%	131	5%	115	5%	120	6%	173	8%
	その他標準IC	704	28%	703	29%	715	32%	620	32%	689	32%
	メモリー	139	6%	113	5%	115	5%	136	7%	181	8%
	アナログ	718	29%	636	26%	587	27%	511	26%	583	27%
	ASSP	332	13%	320	13%	337	15%	249	13%	269	12%
	ASIC	76	3%	35	1%	41	2%	43	2%	41	2%
	PLD	313	13%	329	14%	240	11%	176	9%	181	8%
YoY QoQ	その他	+67%	+29%	+245%	+134%	+2%	▲61%	+63%	+38%	+3%	▲18%
	電子デバイス	+11%	+17%	▲20%	▲13%	▲27%	▲12%	▲7%	+4%	+14%	+44%
	その他標準IC	+50%	+28%	+35%	▲0%	+25%	+2%	+12%	▲13%	▲2%	+11%
	メモリー	▲60%	▲6%	▲55%	▲19%	▲57%	+2%	▲8%	+19%	+30%	+33%
	アナログ	+19%	▲3%	▲7%	▲11%	▲21%	▲8%	▲31%	▲13%	▲19%	+14%
	ASSP	+8%	+1%	▲3%	▲4%	▲6%	+5%	▲24%	▲26%	▲19%	+8%
	ASIC	+25%	+35%	▲38%	▲54%	▲24%	+15%	▲23%	+7%	▲46%	▲5%
	PLD	+38%	+0%	+48%	+5%	▲20%	▲27%	▲44%	▲26%	▲42%	+3%

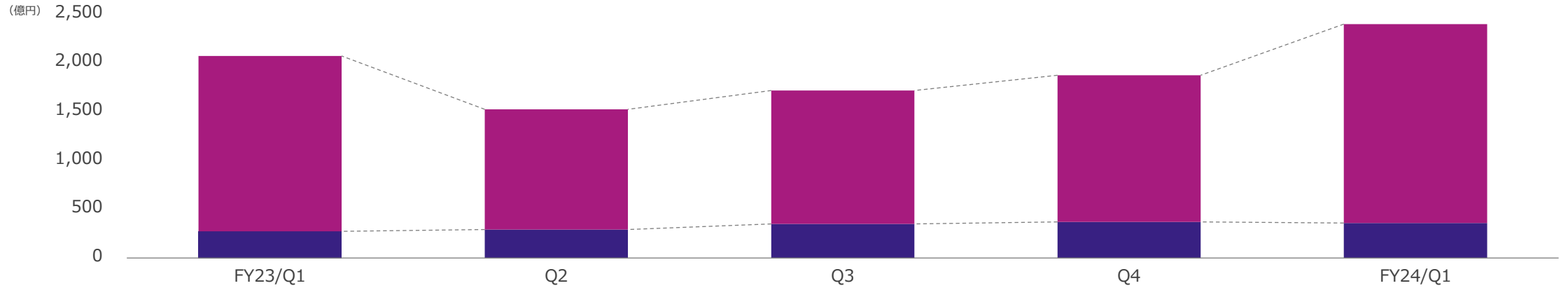
四半期推移 ネットワーク事業（品目別）：売上高



実績 構成比 (億円 %)	品目	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1	
		金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
実績 構成比 (億円 %)	ハードウェア	37	13%	35	13%	43	13%	35	10%	36	9%
	ソフトウェア	203	72%	181	70%	232	72%	257	75%	295	78%
	サービス	44	15%	44	17%	47	15%	50	15%	46	12%

YoY QoQ	品目	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1	
		YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ
YoY QoQ	ハードウェア	▲23%	▲5%	▲13%	▲7%	+8%	+22%	▲11%	▲18%	▲5%	+2%
	ソフトウェア	+57%	▲3%	+15%	▲11%	+45%	+28%	+23%	+11%	+45%	+15%
	サービス	+4%	▲7%	▲2%	+0%	+7%	+8%	+7%	+6%	+5%	▲8%

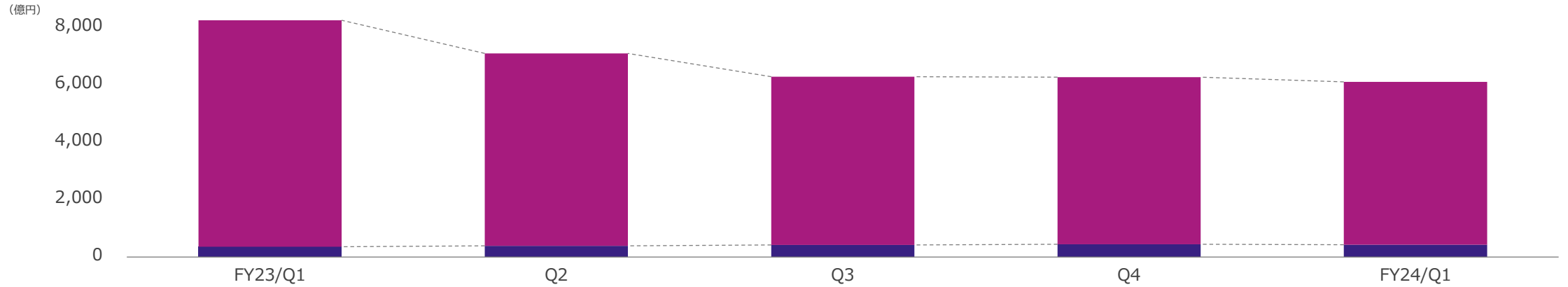
四半期推移 セグメント別：受注高



実績 構成比 (億円 %)	セグメント	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1	
		金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率	金額	比率
実績 構成比 (億円 %)	半導体	1,798	87%	1,233	81%	1,368	80%	1,504	80%	2,039	85%
	ネットワーク	273	13%	291	19%	348	20%	370	20%	357	15%

YoY QoQ	セグメント	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1	
		YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ
YoY QoQ	半導体	▲54%	+69%	▲56%	▲31%	▲31%	+11%	+41%	+10%	+13%	+36%
	ネットワーク	+19%	▲8%	+16%	+6%	+36%	+20%	+24%	+6%	+31%	▲3%

四半期推移 セグメント別：受注残高



実績 構成比 (億円 %)	セグメント	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1	
		金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比	金額	構成比
	半導体	7,904	96%	6,713	94%	5,870	93%	5,830	93%	5,683	93%
	ネットワーク	362	4%	393	6%	419	7%	446	7%	427	7%

YoY QoQ	セグメント	FY23/Q1		Q2		Q3		Q4		FY24/Q1	
		YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ
	半導体	▲20%	▲8%	▲35%	▲15%	▲41%	▲13%	▲32%	▲1%	▲28%	▲3%
	ネットワーク	+3%	▲3%	+9%	+9%	+13%	+7%	+20%	+7%	+18%	▲4%

MACNICA